(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-283950

(43)公開日 平成11年(1999)10月15日

(51) Int.Cl.6

體別記号

H01L 21/304 B08B 11/02

643

FΙ

H01L 21/304

B 0 8 B 11/02

643A

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平10-103705

(22)出顧日

平成10年(1998) 3月30日

(71)出顧人 000000239

株式会社在原製作所

東京都大田区羽田旭町11番1号

(72)発明者 松田 尚起

東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社

在原製作所內

(72)発明者 太田 嘉幸

東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社

在原製作所内

(72)発明者 伊藤 賢也

東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社

在原製作所内

(74)代理人 弁理士 熊谷 隆 (外1名)

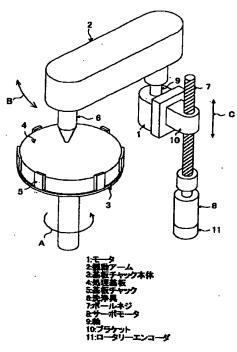
最終質に続く

(54) 【発明の名称】 基板洗浄装置

(57)【要約】

【課題】 洗浄具の高さの変更作業が容易で且つより微 細な高さの調整が可能で、洗浄具の固体差や処理基板の 把持時に洗浄面の位置にバラツキがあっても洗浄結果に 影響を与えることがなく、再現性のよい洗浄が行える基 板洗浄装置を提供すること。

【解決手段】 回転する処理基板4に洗浄液を供給しな がら揺動する揺動アーム2に取り付けた洗浄具6で洗浄 する基板洗浄装置において、洗浄具6を昇降させる昇降 機構(ボールネジ7、サーボモータ8等)と、該洗浄具 の高さを設定する設定手段と、該昇降機構を制御し該洗 浄具の高さを該設定手段で設定された高さに調整する制 御手段を具備する。また、制御手段は、1枚の処理基板 を洗浄する際、洗浄具6の処理基板4に対する高さを段 階的に変更し、繰り返し洗浄できる機能を有すること。



本発明に係る洗浄装置の振路構成

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 回転する処理基板に洗浄液を供給しなが ら揺動するアームに取り付けた洗浄具で洗浄する基板洗 浄装置において、

前記洗浄具を昇降させる昇降機構と、該洗浄具の高さを 設定する設定手段と、該昇降機構を制御し該洗浄具の高 さを該設定手段で設定された高さに調整する制御手段を 具備することを特徴とする基板洗浄装置。

【請求項2】 請求項1に記載の基板洗浄装置におい て、

前記制御手段は、1枚の処理基板を洗浄する際、前記洗 浄具の処理基板に対する高さを段階的に変更し、繰り返 し洗浄できる機能を有することを特徴とする基板洗浄装

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体ウエハ等の処 理基板を洗浄具を用いて洗浄する基板洗浄装置に関する ものである。

[0002]

【従来の技術】図4は、従来のこの種の洗浄装置の概略 構成を示す外観図である。図4において、105はウエ ハ等の処理基板104を把持する基板チャックであり、 基板チャック105は基板チャック本体103上に環状 に等間隔で配設されている。102はモータ101で矢 印 B 方向に揺動する揺動アームであり、該揺動アーム 1 02の先端部に洗浄具106が取付けられている。10 7は揺動アーム102を昇降させるエアシリンダであ り、108は機械的ストッパーである。

【0003】上記構成の洗浄装置において、基板チャッ ク本体103は矢印Aに示す方向に回転し、揺動アーム 102は矢印Bのように揺動する。洗浄具106として は、超音波ノズル、キャビジェットノズル、ペンシル型 のスポンジ等がある。このうち超音波ノズルでは周波数 及び焦点の関係上、またキャビテーションジェットでは キャビテーションの適度な消長の関係上、処理基板10 4と洗浄具106の位置関係を特に厳密にコントロール する必要がある。洗浄具106は高さ方向に関してはエ アシリンダー107で駆動されて昇降する。そしてスト ロークエンド付近に取り付けた機械的ストッパー108 40 ータリーエンコーダ、12はサーボアンプ、13はコン で下降端位置は精密調整され位置決めされている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来の方法では、ウエハ等の処理基板104と洗浄具10 6との位置関係を変更するためには、洗浄装置の運転を 一旦中断し、人手にて調整する必要があった。また、キ ャビジェット洗浄においてはキャビジェットノズルの固 体差や、処理基板104を基板チャック105で把持す る毎の該処理基板104の洗浄面の高さ精度が洗浄のプ ロセス結果に及ぼす影響が大きいため、洗浄結果の再現 50 れる。従って、洗浄具6は設定盤14で設定された高さ

性が充分とはいえないという問題があった。

【0005】本発明は上述の点に鑑みてなされたもの で、洗浄具の高さの変更作業が容易で且つより微細な高 さの調整が可能な基板洗浄装置を提供することを目的と する。

【0006】また、洗浄具の固体差や処理基板の把持時 に洗浄面の位置にバラツキがあっても洗浄結果に影響を 与えることがなく、再現性のよい洗浄が行える基板洗浄 装置を提供することを目的とする。

10 [0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため 請求項1に記載の発明は、回転する処理基板に洗浄液を 供給しながら揺動するアームに取り付けた洗浄具で洗浄 する基板洗浄装置において、洗浄具を昇降させる昇降機 構と、該洗浄具の高さを設定する設定手段と、該昇降機 構を制御し該洗浄具の高さを該設定手段で設定された高 さに調整する制御手段を具備することを特徴とする。

【0008】また、請求項2に記載の発明は、請求項1 に記載の基板洗浄装置において、制御手段は、1枚の処 理基板を1サイクルで洗浄する際、前記洗浄具の処理基 板に対する高さを段階的に変更し、繰り返し洗浄できる 機能を有することを特徴とする。

[0009]

20

30

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態例を図 面に基づいて説明する。図1は本発明に係る洗浄装置の 概略構成を示す外観図である。図1において、5はウェ ハ等の処理基板 4 を把持する基板チャックであり、該基 板チャック5は基板チャック本体3上に環状に等間隔で 配設されている。2はモータ1で軸9を中心に揺動する 揺動アームであり、該揺動アーム2の先端部に洗浄具6 が取付けられている。7はボールネジで、該ボールネジ 7をサーボモータ8により回転させることにより、ブラ ケット10を介して揺動アーム2は矢印Cに示すように 昇降する。また、基板チャック本体3は矢印Aに示すよ うに回転し、揺動アーム2は矢印Bに示すように揺動す

【0010】図2は揺動アーム2を昇降させて洗浄貝6 を昇降させる制御装置の概略構成を示す図である。図2 において、11はサーボモータ8の回転量を検出するロ トローラ、14は設定盤である。該設定盤14は洗浄治 具の高さ等を任意に設定できるようになっており、該設 定盤14で洗浄具6の高さを設定すると、その設定信号 はコントローラ13に入力され、該コントローラ13で 設定信号に基づくサーポモータ8の回転量すなわち洗浄 治具の高さ変化に相当する量を演算し、該演算値に相当 した出力がサーボアンプ12から動力線15を通してサ ーポモータ8に送られ、該サーボモータ8の回転量は信 号線16を通してサーボアンプ12にフィードバックさ

位置に精度良く位置決めされる。

【0011】サーボモータ8が回転するとそれに連動して、ボールネジ7が回転し、その回転量に応じてブラケット10が昇降し、洗浄具6が揺動アーム2を介して昇降する。これにより洗浄具6の高さは設定盤14で設定された設定値に精度よく位置決めされる。

【0012】上記構成の洗浄装置において、1枚の処理 基板4を洗浄する際に、洗浄具6の高さを揺動アーム2 の揺動に同期させて段階的に変更し、繰り返し洗浄する 機能をコントローラ13に持たせることで、洗浄具6の 10 固体差や処理基板4を基板チャック5で把持した時の洗 浄面の位置のバラツキに対処できる。

【0013】図3は洗浄具6の高さを揺動アーム2の揺動に同期させて段階的に変更する制御フローを示す図である。まず、設定盤14で洗浄開始時の洗浄具6の高さhと、洗浄具6を微小下降させる下降量Δhと、洗浄具6を微小下降させるまでの揺動アーム2の揺動回数n及びこの洗浄具6の微小下降を何度繰り返すかの繰返し回数(洗浄具6の高さの段階的な変更回数)Nを設定する(ステップST1)。

【0014】この状態で洗浄動作を開始する(ステップSTST2)。先ず洗浄具6の高さをhにし(ステップST3)、洗浄具6の高さがhになったことを確認したら(ステップST4)、揺動アーム2の揺動を開始する(ステップST5)。揺動アーム2の揺動回数が微小下降の揺動回数nに達したか否かを判断し(ステップST6)、揺動回数nに達したら洗浄具6を下降量 Δ hだけ下降したことを確認し(ステップST7)、洗浄具6が Δ hだけ下降したことを確認し(ステップST8)、設定繰返し回数NをN-1とする(ステップST9)。続いて、N=0か否か、即ち、洗浄具6の微小下降が設定繰返し回数Nに達したか否かを判断し(ステップST10)、設定程返し回数Nに達していなかったら、前記ステップST5に戻り処理を繰返す。設定繰返し回数Nに達したら、洗浄動作を終了する(ステップST11)。

【0015】洗浄装置を上記のように構成することにより、オペレータは設定盤14を操作して設定するのみで、処理基板4に対する洗浄具6の高さを設定できるから、洗浄具6の位置設定を従来のように洗浄装置の運転を一旦停止して手作業で行うことなく、洗浄具6の位置 40決め及びその変更作業が極めて容易になる。

【0016】また、コントローラ13に洗浄具6の高さを揺動アーム2の揺動に同期させて段階的に変更(微小に下降させる)させながら洗浄させる制御機能を持たせることにより、上記のように、洗浄具6の固体差や処理基板4を基板チャック5で把持した時の洗浄面の位置のパラツキに対処できる。即ち、洗浄結果の再現性が向上する。

【0017】なお、上記例では、洗浄具6を昇降させる 5 昇降機構として、サーボモータ8でボールネジ7を回転 50 6

させることより、揺動アーム2を昇降させて洗浄具6を 昇降させるように構成しているが、昇降機構はこれに限 定されるものではなく、要は設定盤14の設定値に応じ て、揺動アーム2を昇降させることができるものであれ ば良い。

4

【0018】また、洗浄具6を昇降させる昇降機構として揺動アーム2を介して昇降させるものに限定されるものではなく、洗浄具6を直接揺動アーム2に対して昇降させる機構であってもよいことは当然である。

【0019】また、本発明の洗浄装置は、処理基板の洗浄のみを行うものに限定されるものではなく、洗浄終了後、基板チャック本体3を高速回転させ、スピン乾燥させる場合等の処理基板の洗浄の前後において、洗浄以外の処理を行う機能を有する場合も本発明の洗浄装置に含まれる。

【0020】洗浄具6としては、超音波ノズル、キャビジェットノズル、ペンシル型のスポンジ等を用いる。特に、本洗浄装置は処理基板4に対する洗浄具6の位置を精度良くコントロールできるから、処理基板4と洗浄具6の位置関係を厳密にコントロールする必要のある超音波ノズルやキャビジェットノズルの洗浄具6に好適である。

[0021]

20

30

【発明の効果】以上説明したように、請求項1に記載の発明によれば、洗浄具を昇降させる昇降機構と、該洗浄具の高さを設定する設定手段と、制御手段を具備するので、処理基板と洗浄具のより精密な位置のコントロールが可能となると同時に、洗浄具の高さを変更する作業性が著しく向上する。

【0022】また、制御手段は、1枚の処理基板を1サイクルで洗浄する際、洗浄具の処理基板に対する高さを段階的に変更し、繰り返し洗浄できる機能を有するので、洗浄具の固体差や処理基板の位置のバラッキに対処でき、洗浄結果の再現性が向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る洗浄装置の概略構成を示す外観図 である。

【図2】揺動アームを昇降させて洗浄具を昇降させる制 御装置の概略構成を示す図である。

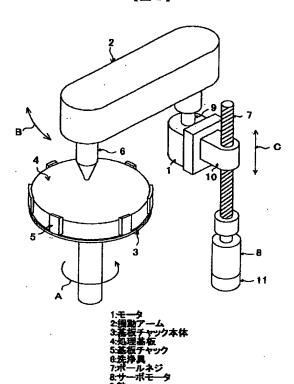
40 【図3】洗浄具の高さを揺動アームの揺動に同期させて 段階的に変更する制御フローを示す図である。

【図4】従来のこの種の洗浄装置の概略構成を示す外観 を示す図である。

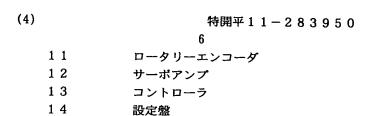
【符号の説明】

1	モータ
2	揺動アーム
3	基板チャック本体
4	処理基板
5	基板チャック
6	洗浄具

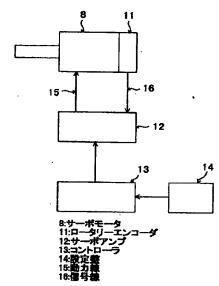
【図1】



本発明に係る洗浄装置の概略構成

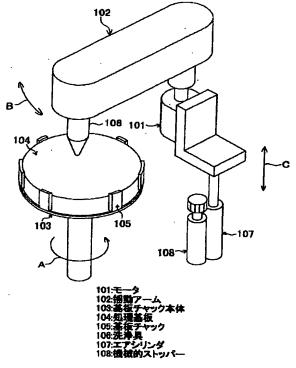


【図2】



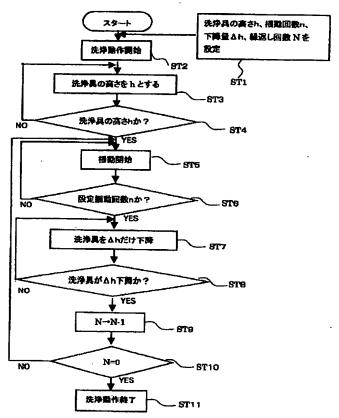
揺動アームを昇降させて洗浄具を昇降させる制御装置の標略構成

【図4】



従来の洗浄装置の概略構成

[図3]



洗浄具の高さを揺動アームの揺動に同期させて段階的に変更する制御フロー

フロントページの続き

(72)発明者 南條 貴弘

東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社 荏原製作所内